



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年2月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス 上場取引所 東
コード番号 6890 URL <https://www.ferrotec.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績（2024年4月1日～2024年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	202,365	20.3	19,696	△5.9	20,516	△11.8	12,612	△6.3
2024年3月期第3四半期	168,266	8.1	20,926	△21.8	23,266	△34.1	13,464	△43.3

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 22,075百万円 (△43.9%) 2024年3月期第3四半期 39,345百万円 (△20.5%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	268.27	235.31
2024年3月期第3四半期	286.76	261.82

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期第3四半期	565,736	297,379	38.2	4,617.45
2024年3月期	510,026	278,166	40.1	4,348.01

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 216,192百万円 2024年3月期 204,409百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	50.00	—	50.00	100.00
2025年3月期	—	55.00	—	—	—
2025年3月期（予想）	—	—	—	55.00	110.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	265,000	19.1	26,000	4.5	26,000	△2.0	16,000	5.6	340.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
新規 -社 (社名) -、除外 -社 (社名) -

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更に関する注記)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2025年3月期3Q	47,117,949株	2024年3月期	47,111,567株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	297,286株	2024年3月期	99,365株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期3Q	47,014,018株	2024年3月期3Q	46,954,288株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 3 ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)	8
(会計方針の変更に関する注記)	8
(追加情報)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間における経営環境については、米国は個人消費や非製造業は良好な状況ですが、製造業は一部生産活動が回復も金利高止まりから設備投資は抑制されている状況です。欧州はユーロ圏、英国もインフレ率鈍化により個人消費や非製造業は良好な一方、製造業は低迷しております。日本は企業の景況感、雇用情勢ともに良好ななか、食料品価格上昇などで個人消費の伸びはやや抑え気味な状況です。中国は輸出の持ち直しや秋口以降の個人消費の回復もみられましたが、持続的な動きとはならず、景気については一進一退の状況です。

為替相場は、対米ドルレートは秋以降円安方向に推移しております。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、中国ローカル資本の半導体製造装置メーカーの需要増加も見込まれ、回復基調にあるなか、顧客在庫等により短期的な需要変動が見られます。一方、太陽光パネル市場は低迷しています。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や金属受託加工、石英・セラミックス、CVD-SiCといった半導体製造プロセス向けマテリアル製品群、部品洗浄などの売上も拡大基調にある一方、顧客在庫等により売上金額が変動しております。

電子デバイス等の事業では、サーモモジュールが通信分野を中心に堅調、パワー半導体用基板も、車載、産業機器向けの販売を伸ばしております。

なお、営業外損益については為替差益が前年同期比で減少しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は202,365百万円（前年同期比20.3%増）、営業利益は19,696百万円（前年同期比5.9%減）、経常利益は20,516百万円（前年同期比11.8%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12,612百万円（前年同期比6.3%減）となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、以下のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値と比較しております。詳細は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等の注記)」に記載しております。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

半導体全体及び半導体製造装置の需要が回復基調のなか、当社の真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品は大幅増収、半導体製造プロセスに使用される石英製品・セラミックス製品、部品洗浄サービスなども、工場稼働率の回復を背景に堅調に売上を伸ばしました。一方、石英坩堝については増収ながら、第3四半期に太陽光パネル製造メーカー向け出荷が伸び悩みました。

この結果、当該事業の122,784百万円（前年同期比25.9%増）、営業利益は10,838百万円（前年同期比17.7%減）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

サーモモジュールは、生成AI関連のサーバー投資の増加に伴い光トランシーバー向けの出荷は引き続き大きく伸びました。パワー半導体用基板についても、産業機械向け等で順調に売上を伸ばしました。また、センサの損益は株式会社大泉製作所の決算期変更により9か月決算となるため2024年4月から9月までの6か月間となっております。

この結果、当該事業の売上高は36,303百万円（前年同期比21.7%増）、営業利益は5,923百万円（前年同期比16.3%増）となりました。

(車載関連事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、センサです。

サーモモジュールは、前年同期比で車載用冷蔵庫等の販売を伸ばしました。パワー半導体用基板については、DCB基板は競争激化影響が続きましたが、AMB基板は電気自動車(EV)向けを中心に売上を伸ばし、全体では増収となりました。また、センサの損益は株式会社大泉製作所の決算期変更により9か月決算となるため2024年4月から9月までの6か月間となっております。

この結果、当該事業の売上高は23,127百万円（前年同期比12.6%増）、営業利益は2,837百万円（前年同期比21.6%減）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

工作機械、業務用洗濯機が前年同期比で増加したものの、太陽電池用シリコン製品の出荷が減少し、部門全体では減収となりました。

この結果、当該事業の売上高は20,150百万円（前年同期比1.2%減）、営業利益は624百万円（前年同期は営業損失22百万円）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

<資産>

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ55,709百万円増加し、565,736百万円となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産22,353百万円、有形固定資産26,619百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ36,496百万円増加し、268,357百万円となりました。これは主に社債（1年内償還予定を含む）3,423百万円が減少したものの、支払手形及び買掛金12,191百万円、短期借入金6,890百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）20,779百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ19,212百万円増加し、297,379百万円となりました。これは主に利益剰余金7,675百万円、為替換算調整勘定4,915百万円、非支配株主持分7,430百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2024年11月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	117,254	114,565
受取手形、売掛金及び契約資産	61,940	84,294
商品及び製品	18,092	19,747
仕掛品	12,875	17,348
原材料及び貯蔵品	25,942	31,646
その他	12,615	13,158
貸倒引当金	△312	△571
流動資産合計	248,408	280,189
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	66,583	84,305
機械装置及び運搬具（純額）	59,533	78,592
工具、器具及び備品（純額）	7,468	8,237
土地	4,660	4,666
リース資産（純額）	12,018	13,761
建設仮勘定	51,075	38,396
有形固定資産合計	201,339	227,959
無形固定資産		
のれん	2,010	1,908
その他	4,600	4,834
無形固定資産合計	6,611	6,742
投資その他の資産		
関係会社株式	32,944	30,496
その他	21,421	21,061
貸倒引当金	△699	△713
投資その他の資産合計	53,666	50,844
固定資産合計	261,618	285,546
資産合計	510,026	565,736

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	38,334	50,526
電子記録債務	3,967	4,575
短期借入金	26,454	33,344
1年内償還予定の社債	3,763	660
1年内返済予定の長期借入金	17,259	18,911
未払法人税等	2,128	2,177
賞与引当金	3,549	3,843
その他	26,691	25,690
流動負債合計	122,148	139,728
固定負債		
社債	320	—
転換社債型新株予約権付社債	25,000	25,000
長期借入金	62,364	81,492
退職給付に係る負債	1,802	1,557
資産除去債務	402	400
その他	19,822	20,177
固定負債合計	109,712	128,628
負債合計	231,860	268,357
純資産の部		
株主資本		
資本金	29,539	29,549
資本剰余金	68,305	68,668
利益剰余金	79,881	87,557
自己株式	△89	△586
株主資本合計	177,638	185,188
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,254	528
為替換算調整勘定	25,316	30,231
退職給付に係る調整累計額	200	242
その他の包括利益累計額合計	26,771	31,003
非支配株主持分	73,756	81,187
純資産合計	278,166	297,379
負債純資産合計	510,026	565,736

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
売上高	168,266	202,365
売上原価	113,841	145,882
売上総利益	54,424	56,482
販売費及び一般管理費	33,498	36,785
営業利益	20,926	19,696
営業外収益		
受取利息	1,410	1,605
補助金収入	2,405	3,838
為替差益	1,829	824
その他	783	606
営業外収益合計	6,428	6,876
営業外費用		
支払利息	1,248	1,932
持分法による投資損失	2,479	3,716
その他	360	407
営業外費用合計	4,087	6,056
経常利益	23,266	20,516
特別利益		
投資有価証券売却益	—	1
持分変動利益	710	6
特別利益合計	710	7
特別損失		
固定資産処分損	123	—
投資有価証券評価損	511	—
減損損失	34	—
特別損失合計	669	—
税金等調整前四半期純利益	23,308	20,524
法人税等	5,222	4,896
四半期純利益	18,085	15,628
非支配株主に帰属する四半期純利益	4,621	3,015
親会社株主に帰属する四半期純利益	13,464	12,612

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	18,085	15,628
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	325	△725
為替換算調整勘定	18,098	6,148
退職給付に係る調整額	94	42
持分法適用会社に対する持分相当額	2,741	981
その他の包括利益合計	21,260	6,446
四半期包括利益	39,345	22,075
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	29,853	17,055
非支配株主に係る四半期包括利益	9,492	5,019

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更に関する注記)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(追加情報)

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

従来、連結子会社のうち決算日または仮決算日が3月31日であった(株)大泉製作所及びその子会社4社は、当社グループの予算編成及び業績管理等、事業運営の効率化を図るため、第1四半期連結会計期間より、決算日を12月31日に変更しております。四半期連結財務諸表の作成に当たっては、決算日が12月31日である連結子会社は、従来、四半期連結決算日で実施した仮決算に基づく四半期財務諸表を使用しておりましたが、決算日を12月31日に変更した連結子会社を含め、四半期決算日(9月30日)現在の四半期財務諸表を使用し、四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行う方法に変更しております。

この変更により、当第3四半期連結累計期間は、2024年4月1日から2024年9月30日までの6か月間を連結しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	12,439百万円	17,295百万円
のれんの償却額	207	102

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	車載関連 事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	97,494	29,829	20,541	147,864	20,401	168,266	—	168,266
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	41	41	△41	—
計	97,494	29,829	20,541	147,864	20,443	168,308	△41	168,266
セグメント利益 又は損失(△)	13,163	5,094	3,617	21,875	△22	21,853	△926	20,926

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△926百万円には、セグメント間取引の消去853百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用73百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	車載関連 事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	122,784	36,303	23,127	182,215	20,150	202,365	—	202,365
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	122,784	36,303	23,127	182,215	20,150	202,365	—	202,365
セグメント利益	10,838	5,923	2,837	19,599	624	20,224	△527	19,696

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益の調整額△527百万円には、セグメント間取引の消去△71百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用598百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、当社グループ内の業績管理区分の一部見直しに伴い、従来「電子デバイス事業」に含まれていた車載向けのサーモモジュール、パワー半導体用基板、センサ製品を「車載関連事業」として記載する方法に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記載しております。